



eBeam Initiativeメンバー企業およびアドバイザーからのコメント

株式会社アドバンテスト

「アドバンテストのEB直描装置 F3000 を design-for-e-beam (DFEB) 手法と組み合わせることにより、スループットが改善できます。弊社は、D2S 社、イー・シャトル社、および富士通マイクロエレクトロニクス社と積極的に協力して、さらなるスループット向上を目指して努力していきます。設計チームによる DFEB 手法の採用を加速するためには、この分野への投資や協業をグローバルに促進していくことが必要ですが、eBeam Initiative はそのための努力を支援するものです。」

— ナノテクノロジー第1事業部 事業部長 坂本 樹一氏

アルチップ・テクノロジーズ・リミテッド

「チップの性能や消費電力を改善するために新しいテクノロジ・ノードを利用しようとする、その適用を阻害する様々な障害に遭遇します。この障害を除去するために不可欠なパートナーとして、アルチップはお客様から厚い信頼を受けています。そして、その障害の一つはマスク費用の高騰ですが、弊社はソリューションにフォーカスした企業として、DFEB 手法を採用することにより、製造手法を簡素化し、コスト効率のよいサービスをお客様に提供することができます。」

— Kinying Kwan氏, CEO

米Altos Design Automation

「DFEB のメリットを活用するためには、フィジカル・ライブラリを最適化することが必要です。eBeam Initiative における Altos 社の役割は、既存のライブラリに修正を加えた場合に、ライブラリの電気的特性（タイミング、消費電力およびノイズ耐性）が大きく変化しないようにすることです。」

— Jim McCanny氏, CEO

米ケイデンス・デザイン・システムズ

「eBeam Initiative は、各社の半導体設計チームに対し、大きな潜在力を秘めた新しい戦略の可能性を提供します。弊社は、設計チームが革新的なアイデアを実際の成果に結び付けられるよう、他の Initiative メンバーと協力して、これを支援することを楽しみにしています。」

— Chi-Ping Hsu 氏, Senior VP, Implementation Group

仏CEA/Leti (フランス原子力庁 電子・情報技術研究所)

「DFEBは、EBのスループットと精度とを同時に、いかにして向上させるかという昔からある問題に対処する新しい革新的な手法です。我々がこのグローバルな業界イニシアティブに参加しているのは、半導体製造環境内でのDFEBテクノロジーの実証実験を通じて、この技術の普及と適用を促進するためです。」

— Serge Tedesco氏, Lithography Program Manager

米D2S

「このような協業を成功させることにより、新しいマスクレス製造アプローチによる無数の恩恵を産業界で共有し、普及していくことができます。現在、業界全体にとって使えるマス

ク費用の予算は、極めて厳しい状況となっています。しかし DFEB を使用することにより、マスク費用を削減しながら、多岐にわたる少量生産の SoC が実現可能になります。」

— Aki Fujimura氏, CEO

大日本印刷株式会社

「eBeam Initiativeとの緊密な協業により、我々は、特に少量生産チップのアプリケーション向けの、最適なリソグラフィ・ソリューションを提供するビジネス・チャンスを模索していきます。」

— 電子デバイス事業部 フェロー 林直也氏

株式会社イー・シャトル

「弊社の製造工程で稼動しているEB直描ツールは、DFEB手法により大幅にスループットが向上します。その結果、弊社のデバイス事業のビジネス・チャンスが拡大し、設計数も増加すると期待しています。」

— シャトル事業部 ジェネラルマネージャー 菅谷慎二氏

米Silicon Corporation

「eSilicon 社は、eBeam Initiative に参加できて光栄です。このテクノロジーはマスク・セット費用の上昇対策の重要な代替案であり、お客様が迅速かつコスト効率よくカスタム・チップを試作し、新しい革新的な技術を市場に早期に提供できるようになると考えています。」

— Jack Harding氏, Chairman, President and CEO

米Fastrack Design

「設計チームは、テクノロジー・スケーリングによる様々な問題を解決するために、設計フローに時間がかかる工程を追加しなければなりません。我々は、設計を容易にし、かつ短期化する、革新的な方法でマスク費用の問題を解決する、DFEBのような新しい手法を喜んでサポートします。」

— Moazzem Hossain氏, CEO

富士通マイクロエレクトロニクス株式会社

「このグローバルな設計・製造のコラボレーションにより、実質的にマスクレスなICというユニークな機能を現実のものとし、世界中の設計数を増加させることができます。弊社は、富士通65ナノメータ低消費電力スタンダードセル・ライブラリにより、DFEBに積極的に協力しています。コスト削減とTime-to-market短縮という形で、このコラボレーションの成果が2009年から現れると期待しています。」

— 取締役 日野 陽司氏

米マグマ・デザイン・オートメーション

「お客様の成功を実現するために、マグマ社は IC 開発コストを削減し、設計者の生産性を向上させるためのソリューションを提供する努力を続けています。DFEB テクノロジーは、マスク費用が削減できるという潜在力を持っており、マグマ社の設計フローを補完できると思います。弊社が積極的に eBeam Initiative に参加するのは、DFEB テクノロジーの開発を支援し、お客様がマグマ社の先端ソフトウェアとともに、DFEB テクノロジーを活用できるようにするためです。」

— Kevin Moynihan氏, General Manager, Design Implementation Business Unit

米PMC-Sierra

「今日の業界をリードする企業からDFEBに対して寄せられる関心が日増しに大きくなっていくことは、業界におけるマスク費用増大の課題に対処するために、DFEBがいかに大きな

可能性を持っているかを示しています。テープアウトへの敷居を低くすることにより、我々は新しいテクノロジー・ノードをいち早く採用し、低電力かつ高性能な、より優れた新製品を目指すことができます。」

— Colin Harris氏, CEO

米クアルコム

「先進的なテクノロジーが物理的な法則の限界に近づいていることは明らかですが、光学リソグラフィはその最も顕著な例です。これまでは、複雑な DFM テクノロジーによって、リソグラフィの課題に対処してきましたが、もはや限界にきています。EBはその代替案の中で信頼できるものの一つであり、eBeam Initiative のような EB 関連企業の協業体制によってその応用範囲が拡大できると考えます。」

— Riko Radojcic氏, Principal Engineer and Manager

STマイクロエレクトロニクス社

「STマイクロ社は、業界のパラダイム・シフトに対して、いつも先頭を切って対応しており、マスクレス・リソグラフィを進展させるeBeam Initiativeにも参加します。弊社は、先端プロセス、SoC設計、そして設計手法の専門性を全て有しているため、ベストのアプリケーション領域を特定し、提案できる立場にあります。」

— Jean-Pierre Geronimi氏, Director of Computer-Aided Design

米Tela Innovations

「Tela社の持つオン・グリッド、直線的、一次元のSoCレイアウト構造は、スルーブット向上とコスト削減に強みを持つEB直描ソリューションと優れたシナジー効果があります。半導体のスケーリングのチャレンジに対し、DFEBのような革新的なソリューションによって業界の進歩に寄与する、eBeam Initiativeに参加できることを嬉しく思います。」

— Neal Carney氏, Vice President of Marketing

凸版印刷株式会社

「少量生産の半導体の設計数を増加させるというeBeam Initiativeの目標を全面的にサポートします。弊社はEB直描ツール向けのステンシル・マスクを製造しておりますが、DFEB手法をさらに効果あるものにするため、積極的に協力を継続していきます。」

— 半導体ソリューション事業本部 取締役副事業本部長 熊本優一氏

米Virage Logic

「弊社のコミットメントは、半導体IP製品の幅広いポートフォリオと共に、新しいプロセスをいち早く市場に提供することです。そのためには継続的な研究開発への投資とSoC設計のパートナー企業との戦略的な協業が求められます。半導体業界において信頼されるIPパートナーとして、弊社は、常に高騰を続けるNREコストとますます短くなる製品のTime-to-marketといった困難な課題に対処する、eBeam initiativeに積極的に参加します。」

— Brani Buric氏, Executive Vice President of Marketing & Sales

独Vistec Electron Beam Lithography Group

「CP機能とDFEBの統合された組合せは、革新的なEB技術と言えます。これにより、最先端の研究開発のための高解像度の要求と、産業界のプロトタイプ応用のためのスルーブット期待値のチャレンジとの橋渡しが可能になります。CP機能は既にVistecから提供可能であり、最近、仏CEA/Leti内に設置されて、協業と研究に供されています。」

— Wolfgang Dorl氏, General Manager

Formatted: German (Germany)

Formatted: German (Germany)

Formatted: German (Germany)